

2026 年 7 月 29 日

三菱ガス化学株式会社

菱茂電子科技股份有限公司の解散について

三菱ガス化学株式会社(本社:東京都千代田区、社長:伊佐早 禎則、以下、当社)が出資し、プリント配線板用積層材料の製造販売を目的として台湾に設立した合弁会社である菱茂電子科技股份有限公司(本社:台湾新竹縣、董事長:原田 亨、以下、菱茂)は、昨日開催された菱茂の株主総会において、会社を解散することを決定いたしました。

今後は所定の手続きに従い、清算に向けた手続きを進めます。清算終了の時期は 2026 年 10 月を予定しております。

菱茂は、当社と台湾の電子材料メーカーである聯茂電子股份有限公司(英語名:ITEQ Corporation、本社:台湾新竹縣、董事長:陳 進財)が、両社が有する技術や設備、知見を活用し、菱茂独自の半導体パッケージ基板用積層材料の新製品を提供することで、拡大かつ多様化していく半導体市場からの要求に応えることを目的に 2022 年に設立されました。しかし、会社設立時からの事業環境の変化が激しく、当初見込んでいた形で事業成長は困難と判断したことから、両社協議の上、解散を決断いたしました。

なお、本件が当社業績に与える影響は軽微です。

当社は今後も「Uniqueness & Presence 事業」の一つである電子材料事業を強化し、拡大する半導体市場のニーズに応えてまいります。

<菱茂電子科技股份有限公司の概要>

会社名 : 菱茂電子科技股份有限公司(英語名:MGC-ITEQ Technology Co., Ltd.)
所在地 : 台湾新竹縣新埔鎮内立里大魯閣路 17 號
設立 : 2022 年 3 月 31 日
資本金 : 100 百万ニュー台湾ドル
出資比率 : 当社 51%、聯茂電子股份有限公司 49%
董事長 : 原田 亨
事業内容 : 半導体パッケージ基板用途を主体とするプリント配線板用積層材料の製造販売

以 上